



A.4.4 探伤灵敏度的校正

在探伤过程中,由于某种原因的底面回波或缺陷回波的高度与 A.4.2.2~A.4.2.3 的调试状态不同时,可校正探伤仪灵敏度,使底面回波或缺陷回波的高度达到荧光屏满幅度的 80%。

A.4.5 探伤速度

手动探测时探头扫查速度不得超过 100 mm/s。

A.4.6 缺陷记录

A.4.6.1 对于图中发现的底面回波降低 10% (由探伤仪状态所造成接触不良所引起的降低)的连续或不连续点进行记录,并以相应的图形表示,并计算其面积。对于基材或复材因其内部缺陷造成的底面回波的降低应不予考虑。

A.4.6.2 非贴合区面积的计算采用图解法计算。

A.4.6.3 贴合率的计算公式

$$t = \frac{S - S_F}{S} \times 100\% \quad \text{(A.1)}$$

式中:

t ——贴合率;

S ——复合板总面积,单位为平方厘米(cm^2);

S_F ——非贴合区总面积,单位为平方厘米(cm^2)。

A.4.6.4 非贴合率的计算公式

$$f = \frac{S_F}{S} \times 100\% \quad \text{(A.2)}$$

式中:

f ——非贴合率;

S ——复合板总面积,单位为平方厘米(cm^2);

S_F ——非贴合区总面积,单位为平方厘米(cm^2)。

A.4.7 探测报告

A.4.7.1 对探伤情况作好详细记录,并填写探伤报告。

A.4.7.2 探伤报告包括:

- a) 委托单位、委托日期、委托编号、合同号、材料名称、规格、状态、类别及探伤条件;